

更なる発展へ！次世代市場を徹底分析！

プリント配線板技術ロードマップの解析

プリント配線板技術ロードマップに関するセミナーをロードマップ委員会より7月26日（月）にオンラインで開催します。

最新の多層版、サブストレート、FPC等のトピックスをご紹介します。

専門家による最新技術動向と製品・市場動向を解説しますので、奮ってご参加ください。



募集要項

配信日時：2021年7月26日（月）13:00～17:00

視聴方法：申込書に必要事項を記載いただき、メールにて申し込みをお願いします。

お申し込み後、メールにて視聴用URLをお送りいたします。

視聴用URLおよび2021年度版プリント配線板技術ロードマップ（ダウンロード版）のダウンロードURLは、お申し込みいただいた方のみご利用いただけます。

※ご注意 Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所で視聴ください。PCでの視聴をお勧めします。

主催：一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

●プログラム（時間は質疑時間5分を含みます。内容については予定であり変更する場合があります。）

13:00-13:40	2021年度版プリント配線板技術ロードマップ総論 宇都宮 久修 (WG5 主査)
13:40-13:45	休憩
13:45-14:30	リジッドプリント配線板技術ロードマップ 戸田 光昭 (株)メイコー)
14:30-14:35	休憩
14:35-15:25	サブストレート技術ロードマップ 中村 清智 (凸版印刷株)
15:25-15:30	休憩
15:30-16:15	フレキシブル&ストレッチャブルエレクトロニクス配線板技術ロードマップ 宇都宮 久修 (WG5 主査)
16:15-17:00	機能集積配線板技術ロードマップ 吉村 英明 (富士通インターコネクトテクノロジーズ株)

●参加要項

定員：先着200名

参加費：

	書籍未購入の方 (聴講料、2021年度版プリント配線板技術ロードマップ（ダウンロード版）代金を含む。)	書籍購入済みの方 (聴講料のみ、書籍をご用意ください)
JPCA/JEITA/JIEP 会員様	20,000円 (税込22,000円)	無料
非会員	50,000円 (税込55,000円)	10,000円 (税込11,000円)

※2021年度版プリント配線板技術ロードマップのダウンロードリンクの発行は、順次ご案内させていただきます。(有効期間1週間)

※お申し込み後、お客様都合によるキャンセルは、本書のダウンロードアドレス発行後はお受け致しかねます。

※ご受講予定者と別の方が受講される場合には、事前にメールでご連絡ください。

※講師の意向により投影資料の配布は致しかねます。

※使用アプリケーションは、Zoom ウェビナーです。初めて使われる方の為に、講演会開催1週間前（詳細は後日ご案内します）に接続試験を行います。

●お問い合わせ 一般社団法人日本電子回路工業会 ロードマップセミナー係

事業部 青木 (std2@jpca.org) TEL : 03-5310-2020 FAX : 03-5310-2021

●申込方法 別紙申込書に必要事項をご入力の上、メールで7月21日（水）迄にお申し込み下さい。

工業会からご担当者様宛にご請求書をお送りさせていただきます。

